

2020-2026年中国半导体封装用引线框架市场研究与市场运营趋势报告

报告目录及图表目录

一、报告报价

《2020-2026年中国半导体封装用引线框架市场研究与市场运营趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0607/201911/01-320113.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

引线框架是一种用来作为集成电路芯片的金属结构载体。引线框架是借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气电路的关键结构件，引线框架是电子信息产业中重要的IC封装材料。

2011-2017年中国引线框

架市场规模及全球份额分析

资料来源：中国产业研究报告网整理

《2020-2026年中国半导体封装用引线框架市场研究与市场运营趋势报告》由中国产业研究报告网公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识产权局、智研数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

报告揭示了半导体封装用引线框架行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国半导体封装用引线框架行业做了重点企业经营状况分析，并分析了中国半导体封装用引线框架行业发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据。

报告目录：

第一章 引线框架产品概述

1.1 引线框架概述

1.1.1 定义

1.1.2 引线框架在半导体封装中的应用

引线框架作为一种框架材料，在半导体封装中充当着电路连接、封装内部散热、芯片机械支撑等重要作用。虽然目前有着多种的封装形式,但无论是金属封装,还是陶瓷封装、塑料封装等都离不开引线框架。

引线框架在半导体封装中的应用及位置

资料来源：公开资料整理

1.1.3 引线框架产品形态

1.1.4 引线框架产品特性与各功能结构

1.2 引线框架的发展历程

1.2.1 引线框架随着半导体封装技术发展而得到发展

1.2.2 当今及未来引线框架技术发展路线图

1.2.3 引线框架主流铜带材料的转变

1.3 引线框架在半导体产业发展中的重要地位

1.3.1 引线框架是适合半导体键合内引线连接的关键结构材料

1.3.2 引线框架在半导体封装中所担负的重要功效

1.3.3 引线框架在半导体封装的性能提高、成本控制上发挥着重要作用

第二章 引线框架产品品种、分类及性能要求

2.1 引线框架主流产品品种的演变

2.2 引线框架的品种分类

2.2.1 按照材料组成成分分类

2.2.2 按照生产工艺方式分类

2.2.3 按材料性能分类

2.2.4 按照使用的不同器件类别分类

2.3 引线框架材料的性能要求

2.3.1 对引线框架材料的性能要求

2.3.2 封装工艺对引线框架的性能要求

2.4 引线框架的国内外相关标准

2.4.1 国内相关标准

2.4.2 国外相关标准

第三章 引线框架的生产制造技术现况

3.1 引线框架成形加工两类工艺方式

3.2 冲制法生产引线框架

3.2.1 冲制法生产引线框架的工艺特点

3.2.2 冲制法的关键技术

3.3 蚀刻法生产引线框架

3.3.1 蚀刻法生产引线框架的工艺原理及过程

3.3.2 与冲制法相比的优点

3.4 引线框架表面电镀处理

3.4.1 引线框架表面电镀层的作用与特点

3.4.2 引线框架电镀的工艺流程及工艺条件

3.4.3 引线框架表面电镀加工生产线的类别

3.4.4 引线框架表面电镀加工工艺的发展

3.4.5 局部电镀技术

3.4.6 SN系无铅可焊性镀层

3.4.7 PPF引线框架技术

3.4.8 国内厂家开发高性能引线框架的电镀技术创新例

第四章 世界引线框架市场需求现状与分析

4.1 世界引线框架市场规模

受全球半导体产业发展态势的影响，近年来全球引线框架需求市场规模波动较为明显，2017年行业市场规模为33.7亿美元。

2004-2013年全球引线框架需求市场规模

资料来源：智研数据中心整理

4.2 世界引线框架产品结构的变化

4.3 世界引线框架市场格局

4.4 世界引线框架市场发展及预测

4.4.1 世界半导体产业发展现状

自从1958年德州仪器发明出世界上第一块集成电路以来，集成电路迅猛发展，历史上大致从西向东形成转移。从上世纪50年代发展至今，集成电路大体经历了三大发展阶段，分别是：在美国发明起源——在日本加速发展——在韩国台湾分化发展。

两次半导体产业转移各有不同历史时期背景下的原因：

第一次产业转移：美国为了寻求更低的加工成本，技术逐渐从美国引渡到日本，日本结合当时在家电行业的积累，在PCDRAM市场获得美国认可，趁着80年代PC产业兴起的东风，日本在1986年超越美国成为全球最大的集成电路生产国家。

第二次产业转移：日本在上世纪90年代受经济危机影响，在DRAM技术升级和晶圆厂投建方面难以给予资金支持，韩国在各大财团的支持下借机成为PCDRAM新的主要生产者，而台湾则凭借Foundry模式的优势，在晶圆代工、芯片封测领域成为代工龙头。

全球半导体产业发展阶段示意图

资料来源：公开资料整理

进入2000年后，计算机增速下滑，PC红利慢慢消退。在第三次产业转移过程中，尤其是2007年苹果发布第一代iPhone，手机取代计算机成为新的集成电路行业驱动因素。

前几年半导体产业成长的主要驱动力是手机为代表的智能终端。预计到2020年，手机和个人电脑的复合增长率CAGR分别在5%和2%左右。随着智能手机的增速放缓至个位数，其对半导体产业的带动效应有所减弱。未来汽车电子、人工智能、物联网等新兴市场将成为推动集成电路产业发展的新的驱动力。

全球半导体产业的销售额已经从2013年的6479.21亿美元增长到2017年的8222.26亿美元，同比增长1.9%。在这期间，全球半导体销售规模平均增速保持在6.4%左右。

2013-2017年全球半导体销售规模

资料来源：中国产业研究报告网整理

4.4.2 世界封测产业及市场现况

4.4.3 世界引线框市场发展前景

第五章 世界引线框架生产现况

5.1 世界引线框架生产总况

5.2 世界引线框架主要生产企业的市场份额情况

5.3 世界引线框架主要生产企业的情况

5.3.1 住友金属矿山公司

5.3.2 日本三井高科技股份公司

5.3.3 台湾顺德工业股份公司

5.3.4 日本新光电气工业公司

5.3.5 日本日立高新技术有限公司

5.3.6 大日本印刷公司

5.3.7 DIC

5.3.8 韩国丰山集团

5.3.9 宁波康强电子股份有限公司

5.3.10 先进半导体物料科技有限公司

第六章 我国国内引线框架市场需求现状

6.1 我国国内引线框架市场需求总述

6.1.1 国内引线框架市场规模

6.1.2 国内引线框架市场总体发展趋势

6.1.3 国内引线框架市场的品种结构

6.2 国内引线框架的集成电路封装市场情况及发展

6.2.1 我国集成电路产业发展现况与展望

6.2.2 国内引线框架重要市场之——集成电路封装产业现况及发展

6.3 国内引线框架的分立器件市场情况及发展

6.3.1 国内分立器件产销情况

6.3.2 国内分立器件的市场情况

6.3.3 国内分立器件封装行业现况

6.4 国内引线框架的LED封装市场情况及发展

6.4.1 引线框架的LED封装上的应用

6.4.2 国内LED封装用引线框架行业情况

6.4.3 国内LED封装产业发展现况与展望

第七章 我国国内引线框架行业及主要企业现况

7.1 国内引线框架产销情况

7.2国内引线框架生产企业总况

7.3 近几年在国内引线框架企业的投建或扩产情况

7.4 当前国内引线框架行业发展的特点与存在问题

7.5 国内引线框架主要生产企业情况

7.5.1 深圳先进微电子科技有限公司

7.5.2 泰州友润电子科技股份有限公司

7.5.5 宁波康强电子股份有限公司

7.5.4 铜陵丰山三佳微电子有限公司

7.5.5 三井高科技（上海）有限公司

7.5.6 中山复盛机电有限公司

7.5.7 厦门永红科技有限公司

7.5.8 无锡华晶利达电子有限公司

7.5.9 广州丰江微电子有限公司

7.5.10 济南晶恒山田电子精密科技有限公司

7.5.11 顺德工业（江苏）有限公司

7.5.12 上海柏斯高微电子工程有限公司

7.5.13 宁波东盛集成电路元件有限公司

7.5.14 宁波华龙电子股份有限公司

7.5.15 成都兴胜半导体材料有限公司

7.5.16 无锡市长通敏感电器厂

7.5.17 江门市鼎翔电子科技有限公司

7.5.18 南京长江电子信息产业集团有限公司

7.5.19 武汉京丰达电子有限公司

7.5.20 四川金湾电子有限责任公司

7.5.21 天水华洋电子科技股份有限公司

7.5.22 泰兴市龙腾电子有限公司

7.5.23 成都尚明工业有限公司

第八章 引线框架材料市场及其生产现况

8.1 国内外引线框架制造业对铜带材料的性能需求

8.1.1 对引线框架材料的主要性能要求

8.1.2 引线框架材料市场在品种需求上的四个阶段的发展变化

8.2 引线框架材料的品种、规格及基本特性

8.2.1 引线框架材料的品种

8.2.2 引线框架制造中常用的铜合金材料品种

8.3 引线框架业对铜合金材料品种需求市场的情况

8.4 引线框架业对铜合金材料需求量的情况

第九章 国内外引线框架用铜合金带材生产技术的发展及主要生产厂家的

9.1 高性能引线框架铜合金材料生产技术

9.1.1 铜合金的熔铸技术

9.1.2 铜带的加工技术

9.2 高性能引线框架铜合金材料生产工艺与设备条件

9.2.1 工艺技术方面

9.2.2 设备条件

9.2.3 国外工业发达国家工艺技术与装备情况

9.2.4 C19400的工艺过程与技术环节要点

9.2.5 获得高强度高导电铜合金的工艺途径

9.3 国外引线框架用铜带的主要生产厂商情况

9.4 国内引线框架用铜带的主要生产厂商情况

9.4.1 我国铜及铜合金板带材的生产与需求情况

9.4.2 我国引线框架用铜合金带材技术开发的情况

9.4.3 我国引线框架用铜合金带材生产总况

9.4.4 我国引线框架用铜合金带材主要生产厂情况

第十章 关于金属层状复合材料在引线框架领域应用前景的调查与分析

10.1 金属层状复合带材及其在国内的研发情况

10.2 金属层状复合材料的引线框架领域应用前景的调查与分析

10.2.1 金属层状复合材料在引线框架领域应用的可行性

10.2.2 对国外同类产品及其应用的调查

10.2.3 对金属层状复合材料的引线框架领域应用前景调查

10.2.4 对金属层状复合材料的引线框架领域市场情况的分析

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0607/201911/01-320113.html>